

報道関係各位

レンゴー株式会社
広報部広報課

当社 東京パック2008出展のお知らせ

レンゴー株式会社（本社：大阪市北区 社長：大坪 清）は、来たる10月7日より東京ビッグサイトにて開催されます『2008 東京国際包装展（東京パック2008）』に出展いたしますのでお知らせします。

今回は、来年2009年が当社創業100周年という節目の年にあたることから「100年の進化、未来への創造」をメインテーマに、これまでの進化と実績を示しながら段ボールをはじめとした『パッケージング・ソリューション・カンパニー』である当社を総合的にPRします。

展示コーナーでは、当社グループのさまざまな商品群に加えて、100年の歴史を示す象徴である段ボール製造機1号（レプリカ）の展示や、デモンストレーションでは店頭の陳列作業を容易にしたシェルフレディパッケージなどを用いて「売り場」を意識したパッケージを各種ご提案いたします。さらに包装展の大きなテーマである環境面にスポットをあて、カーボンフットプリント（商品のCO2排出量の表示）、CO2排出削減など当社の環境に対する取り組み、ノンステープル段ボール、Cフルーツなどをはじめとした環境配慮型製品の展示を行います。

お時間がございましたら、ぜひともご高覧賜りますようご案内申しあげます。

<東京パック開催概要>

1. 名称 2008 東京国際包装展 —東京パック2008—
2. テーマ 包装が はぐくむ環境 きれいな地球
3. 日程 2008年10月7日（火）～10月11日（土）5日間
4. 場所 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東ホール全館
東京都江東区有明3-11-1
5. 主催 社団法人日本包装技術協会
6. 特色 1966年の第1回から隔年開催でこれまで計21回の実績を持ち、アジア地域最大規模を誇る包装展示会。日本国内はもとより海外も含めた全包装関係者から注目される世界有数の国際包装展。

<レンゴー出展概要>

1. 小間位置 東1ホール 1C-04
2. 展示コンセプト
— The Packaging Solutions Company —
『100年の進化、未来への創造』
～歴史から生まれた技術、新価値創造への挑戦～



以上